



本社：〒160-8366

東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100518000

2010 年 5 月 25 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)HPA/PWR SOIC(8/14 ピン D, 20 ピン DW)パッケージ 一部製品 組立サイト追加予定のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきまして下記にご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

敬具

－ 記 －

通知タイプ	☒ Initial notice (Plan)	☐ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site ☐ Process ☐ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	☒ Others	☒ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	HPA/PWR SOIC(8/14 ピン D, 20 ピン DW)パッケージ 一部製品 組立サイト追加 現行：TI-Taiwan(台湾) 変更後：TI-Taiwan(台湾), TI-Malaysia(マレーシア)	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	9 月上旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	☒ 計画	☐ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	－	

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更内容

内容: 今回のお知らせは、下記変更実施についての一次予定の連絡になります。最終的なお知らせは、弊社内変更審査が終了次第、認定試験の結果を含め、本PCNの更新版の発行をもって連絡させていただきます。尚、変更品の出荷につきましては、本通知の90日以降に予定いたしております。

弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ)及びPWR(パワーマネジメント) SOIC(8/14ピンD, 20ピンDW)パッケージ 一部製品の組立サイトについて、現行 TI-Taiwan(台湾)サイトにおいて製造いたしておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-Malaysia(マレーシア)サイトを追加する予定です。TI-Malaysiaサイトにおいて、SOICパッケージ製品は認定されています。下記信頼性試験結果(2004年11月7日、2008年1月13日終了)を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容
組立サイト

現行
TI-Taiwan(台湾)

変更後
TI-Taiwan(台湾)
TI-Malaysia(マレーシア)

理由: 供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名				
HPA00299DR	TLC274ACD	TLC27L4A1DG4	TLE2072A1DG4	TPS2812DR
SN65HVD1050D	TLC274ACDG4	TLC27L4A1DR	TLE2072A1DR	TPS2812DRG4
SN65HVD1050DG4	TLC274ACDR	TLC27L4A1DRG4	TLE2072A1DRG4	TPS2814D
SN65HVD1050DR	TLC274ACDRG4	TLC27L4BCD	TLE2072CD	TPS2814DG4
SN65HVD1050DRG4	TLC274A1D	TLC27L4BCDG4	TLE2072CDG4	TPS2814DR
SN65HVD33D	TLC274A1DG4	TLC27L4BCDR	TLE2072CDR	TPS2814DRG4
SN65HVD33DG4	TLC274A1DR	TLC27L4BCDRG4	TLE2072CDRG4	TPS3705-30D
SN65HVD33DR	TLC274A1DRG4	TLC27L4B1D	TLE20721D	TPS3705-30DG4
SN65HVD33DRG4	TLC274BCD	TLC27L4B1DG4	TLE20721DG4	TPS3705-30DR
TLC0838CDW	TLC274BCDG4	TLC27L4B1DR	TLE20721DR	TPS3705-30DRG4
TLC0838CDWG4	TLC274BCDR	TLC27L4B1DRG4	TLE20721DRG4	TPS3707-30D
TLC0838CDWR	TLC274BCDRG4	TLC27L4CD	TLV3402CD	TPS3707-30DG4
TLC0838CDWRG4	TLC274B1D	TLC27L4CDG4	TLV3402CDG4	TPS3707-30DR
TLC08381DW	TLC274B1DG4	TLC27L4CDR	TLV3402CDR	TPS3707-30DRG4
TLC08381DWG4	TLC274B1DR	TLC27L4CDRG4	TLV3402CDRG4	TPS7101QD
TLC08381DWR	TLC274B1DRG4	TLC27L41D	TLV34021D	TPS7101QDG4
TLC08381DWRG4	TLC274CD	TLC27L41DG4	TLV34021DG4	TPS7101QDR
TLC084A1D	TLC274CDG4	TLC27L41DR	TLV34021DR	TPS7101QDRG4
TLC084A1DG4	TLC274CDR	TLC27L41DRG4	TLV34021DRG4	TPS76633D
TLC084A1DR	TLC274CDRG4	TLC77331DR	TLV5638CD	TPS76633DG4
TLC084A1DRG4	TLC2741D	TLC77331DRG4	TLV5638CDG4	TPS76633DR
TLC084CD	TLC2741DG4	TLC7733QD	TLV5638CDR	TPS76633DRG4
TLC084CDG4	TLC2741DR	TLC7733QDG4	TLV5638CDRG4	TPS76801QD
TLC084CDR	TLC2741DRG4	TLC7733QDR	TLV56381D	TPS76801QDG4
TLC084CDRG4	TLC27L4ACD	TLC7733QDRG4	TLV56381DG4	TPS76801QDR
TLC0841D	TLC27L4ACDG4	TLE2072ACD	TLV56381DR	TPS76801QDRG4
TLC0841DG4	TLC27L4ACDR	TLE2072ACDG4	TLV56381DRG4	
TLC0841DR	TLC27L4ACDRG4	TLE2072ACDR	TPS2812D	
TLC0841DRG4	TLC27L4A1D	TLE2072A1D	TPS2812DG4	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地コード(ラベル箇所:22L, 23L)及び製品捺印が下記の様になる予定です。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)	組立国コード(23L)
現行	TI-Taiwan	ASO: TAI	ACO: TWN
追加認定	TI-Malaysia	ASO: MLA	ACO: MYS



図1 出荷ラベルの例

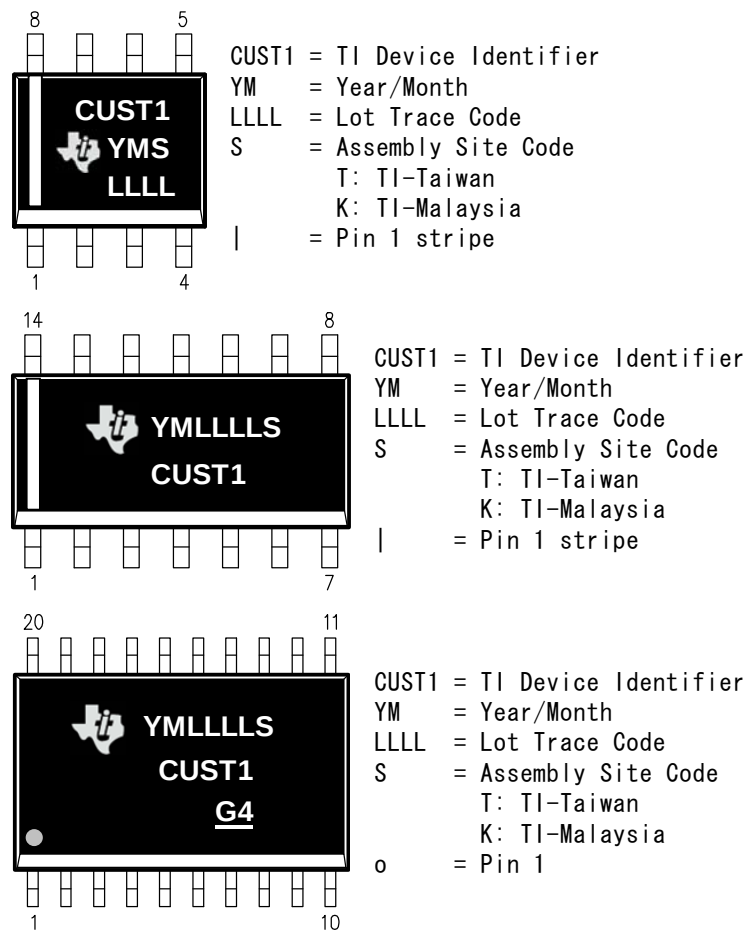


図2 捺印表示の例 (8/14ピンD, 20ピンDWパッケージ)

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2010 年 3 月	終了	2010 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TLC7733ID	Die Size (mm):	1.448 X 1.753	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size	
Assembly MQ	Per AT site spec. (MLA)		per spec	
Yield Evaluation	FT yield & Bin summary		per spec	

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2010 年 3 月	終了	2010 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS3705-30D	Die Size (mm):	1.168 X 1.270	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験計画				
Reliability Test		Condition / Duration	Sample Size	
Assembly MQ		Per AT site spec. (MLA)	per spec	
Yield Evaluation (TPS3705-30D)		FT yield & Bin summary	per spec	
Yield Evaluation (TPS3707-30D)		FT yield & Bin Summary	per spec	

信頼性試験計画

信頼性試験期間	開始	2010 年 3 月	終了	2010 年 6 月
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2812D	TPS2814D		
Die Size (Mils):	47 X 57	47 X 57		
Die Protective Coating:	10 KAN	10 KAN		
Assembly Site:	TI Malaysia	TI Malaysia		
Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	SOIC/D/8		
Mount Compound:	4042500	4042500		
Mold Compound:	4205694	4205694		
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au	0.96 Mil Dia., Au		
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	NiPdAu, Cu		
信頼性試験計画				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size		
		TPS2812D	TPS2814D	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	
Manufacturability (Test)	per mfg. Site specification	per spec	per spec	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2085D	Die Size (mils):	54 X 72 (dual die)	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	2.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL :	JEDEC L-1/260C	-	-	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	-
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	-
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -1 /260C				

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qual Device:	SN75976A1DL	Die Size (mils):	301 X 122	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DL/56	
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL :	JEDEC L-3/260C	-	-	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
**Life Test	155C, 240 Hours	116/0	116/0	116/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -3 /260C				

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2211ADB	Die Size (mils):	118 X 63	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DB/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL :	JEDEC L-1/260C	-	-	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	40/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	40/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -1 /260C				

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2201DB	Die Size (mils):	142 X 204	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DB/30	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	2.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL :	JEDEC L-1/260C	-	-	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	40/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	40/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -1 /260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	BQ3285ESS	Die Size (mils):	88 X 105	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DBQ/24	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL :	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -2 /260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 1 月 13 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device1		Device2	
Qual Device:	MSA00021DG4		LM2901QDG4Q1	
Die Size (Mils):	81 X 131		48 X 49	
Die Protective Coating:	10KACN		10KACN	
Assembly Site:	TI Malaysia		TI Malaysia	
Package/Code/Pins:	SOIC/D/16		SOIC/D/14	
Mount Compound:	4042500		4147858	
Mold Compound:	4205694		4205694	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au		0.8 Mil Dia., Au	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu		NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Device1/Lot1	Device1/Lot2	Device2
**Life Test	150C, 408 Hours	77/0	77/0	77/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hours	231/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	231/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 Hours	231/0	-	-
Solderability	>95% coverage, 8 hour Steam Age	22/0	22/0	22/0
Physical Dimensions	-	10/0	10/0	10/0
Manufacturability (Assembly)	-	-	Approved	-
Notes: ** Preconditioning sequence, JEDEC Level -1/260C				